

成都宏科电子科技有限公司陶瓷封装外壳自动装架机项目（第二次）比选公告

成都宏科电子科技有限公司（以下简称“宏明宏科”或“比选人”）根据相关规定和要求，拟通过公开比选方式选聘“成都宏科电子科技有限公司陶瓷封装外壳自动装架机项目（第二次）”的制造单位，相关情况如下：

一、项目概况与比选范围

- 1.项目业主（比选人）：成都宏科电子科技有限公司
- 2.项目名称：陶瓷封装外壳自动装架机
- 3.项目地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿）星光中路20号
- 4.项目概况：本项目为成都宏科电子科技有限公司2022年设备技改项目中其中1台，该项目已报公司并通过。
- 5.比选范围及内容：此次比选采购的是陶瓷封装外壳自动装架机1台，适用于HTCC集成电路封装产品在钎焊工序的产品装架。

6.交货期：120个日历天

7.标段划分：一个标段

二、比选申请人资格要求

- 1.项目投标人要求：需为合法有效的独立法人资格；
- 2.企业类似业绩要求：无要求；
- 3.其他要求：未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于四川省行政区域内有关政处罚期间（信用中国查询截图）；
- 4.联合体：本次比选不接受联合体。（提供承诺函）

注：以上资料需加盖单位鲜章。

三、报名及比选文件的获取

1.符合公告要求、有意参加比选者，请于 2024年4月16日至2024年4月21日，每日上午 8:30 时至 12:00 时，下午 13:30 时至 17:00 时（北京时间，下同），进行报名及获取比选资料。

2.报名方式：电话联系工作人员梁霄 18848427057/028-84866230，将加



盖单位鲜章的电子版报名资料(比选申请人资格要求资料与介绍信、身份证复印件、营业执照)发送至邮箱(liangxiao@chinahongke.com)进行报名登记获取电子版比选资料。

四、比选申请文件的递交

1.比选申请文件递交截止时间(投标截止时间)为2024年4月22日10时,地址为:四川省成都经济技术开发区(龙泉驿)星光中路20号。

2.比选申请文件共1套(正本一份,副本两份,电子档一份),文件袋标注比选申请人名称和比选项目名称,密封条加盖单位鲜章。

3.逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件以及未按照要求密封的比选申请文件,比选人不予受理。

4.比选人定于北京时间2024年4月22日10时在四川省成都市龙泉驿区星光中路20号会议室举行比选申请文件开启仪式。比选人邀请已递交符合比选公告的比选申请文件的比选申请人到现场,到场的比选申请人法定代表人或授权代理人应当对本单位递交的比选申请文件开启情况签字确认。以上内容如有变化,比选人将另行通知。

五、比选公告发布媒体

本次比选公告在成都宏明电子股份有限公司(<http://www.chinahongming.com/>)、成都宏科电子科技有限公司(<http://www.chinahongke.com/>)、天府阳光采购服务平台(<https://www.tfygcfgw.com/>)上发布。

六、联系方式

比选人:成都宏科电子科技有限公司

地址:四川省成都经济技术开发区(龙泉驿)星光中路20号

联系人:梁女士

电话:028-84847220 18848427057

传真:/

